

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

公告编号：2023-020

# 湖北鼎龙控股股份有限公司 2022 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户上已回购股份 11,820,214 股后的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	鼎龙股份	股票代码	300054
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨平彩	黄云	
办公地址	武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号	武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号	
传真	027-59720699	027-59720677	
电话	027-59720699	027-59720677	
电子信箱	ypc@dl-kg.com	huangyun@dl-kg.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### (1) 半导体材料业务

##### ①主要业务

鼎龙股份是国内领先的关键大赛道领域中各类核心“卡脖子”进口替代类创新材料的平台型公司，目前重点布局半导体材料领域中：半导体CMP制程工艺材料、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块，着力攻克国家战略性新兴产业

产业（集成电路、新型显示）被国外卡脖子、保障供应链安全的核心关键材料。在半导体CMP制程工艺材料板块，公司围绕集成电路前段制程中的化学机械抛光（CMP）环节几款核心材料进行布局；在半导体显示材料板块，公司围绕柔性OLED显示屏幕制造用的上游核心“卡脖子”材料：YPI、PSPI、INK等产品进行布局；在半导体先进封装材料板块，公司前瞻性探索布局临时键合胶、封装光刻胶（PSPI）、底部填充胶等先进封装上游材料产品。

## ②主要产品及其用途

a. 半导体CMP制程工艺材料板块：公司围绕集成电路前段制造中的化学机械抛光（CMP）环节进行布局，致力为客户提供整套的一站式CMP材料及服务。产品包括CMP抛光垫、CMP抛光液、清洗液三大CMP环节核心耗材，合计占CMP抛光材料总成本的85%以上。

表 2.1：公司半导体 CMP 制程工艺材料板块产品简介

产品名称	图片	简介
CMP 抛光垫		CMP抛光垫是CMP环节的核心耗材之一，主要作用是储存和运输抛光液、去除磨屑和维持稳定的抛光环境等。
CMP 抛光液		CMP抛光液是研磨材料和化学添加剂的混合物，在化学机械抛光过程中可使晶圆表面产生一层氧化膜，再由抛光液中的磨粒去除，达到抛光的目的。
CMP 清洗液		清洗液主要用于去除残留在晶圆表面的微尘颗粒、有机物、无机物、金属离子、氧化物等杂质，满足集成电路制造对清洁度的极高要求，对晶圆生产的良率起到了重要的作用。

b. 半导体显示材料板块：公司围绕柔性OLED显示屏幕制造用的上游核心“卡脖子”材料布局，推出OLED柔性显示面板基材YPI、OLED显示用光刻胶PSPI、面板封装材料INK等系列产品。OLED具备多重技术优势，渗透率持续提升，下游笔电、平板、TV等领域应用有望持续放量，带动国内OLED产能持续快速增长。OLED面板产业上游核心原材料供应链自主化程度低，国内替代空间广阔。

表 2.2：公司半导体显示材料板块产品简介

产品名称	图片	简介
黄色聚酰亚胺浆料 YPI		YPI是生产柔性OLED显示屏幕的主材之一，具有优良的耐高温特性、良好的力学性能以及优良的耐化学稳定性，在OLED面板前段制造工艺中涂布、固化成PI膜（聚酰亚胺薄膜），替换刚性屏幕中的玻璃材料，实现屏幕的可弯折性。
光敏聚酰亚胺 PSPI		PSPI是一种高分子感光复合材料，具有优异的热稳定性、良好的机械性能、化学和感光性能等，是AMOLED显示制程的光刻胶，是除发光材料外的核心主材，是AMOLED显示屏中唯一一款同时应用在三层制程的材料，在OLED制程中用于平坦层、相素定义层、支撑层三层。
面板封装材料 INK		INK是柔性显示面板的封装材料，在柔性OLED薄膜封装工艺中，通过喷墨打印的方式沉积在柔性OLED器件上，起到隔绝水氧的作用。

c. 半导体先进封装材料板块：公司围绕半导体先进封装上游几款自主化程度低、技术难度高、未来增量空间较大的材料产品进行布局，目前重点开发临时键合胶（TBA）、封装光刻胶（PSPI）、底部填充胶（Underfill）等产品。先进封装是超越摩尔定律的关键赛道，先进封装材料则是先进封装技术发展的基石。目前多款先进封装材料被国外企业垄断，供应链

自主化率几乎为零，行业严重被“卡脖子”。

表 2.3：公司半导体先进封装材料板块产品简介

产品名称	图片	简介
临时键合胶 TBA		临时键合胶作为超薄晶圆减薄、拿持的核心材料，可将器件晶圆临时固定在承载载体上，从而为超薄器件晶圆提供足够的机械支撑，防止器件晶圆在后续工艺制程中发生翘曲和破片，最后临时键合胶可通过光、热和力等解键合方式完成超薄晶圆的释放。临时键合胶在先进封装中的应用领域主要是2.5D/3D封装。
封装光刻胶 PSPI		封装光刻胶PSPI是一种光敏性聚酰亚胺材料，兼具光刻胶的图案化和树脂薄膜的应力缓冲、介电层等功能，主要应用于晶圆级封装（WLP）中的RDL（再布线）工艺中，使用时先涂覆在晶圆表面，再经过曝光显影、固化等工艺，可得到图案化的薄膜。
底部填充胶 Underfill		底部填充胶作为一种重要的集成电路封装电子胶黏剂，在先进封装如2.5D、3D封装中，用于缓解芯片封装中不同材料之间热膨胀系数不匹配带来的应力集中问题，进而提高器件封装可靠性。

### ③经营模式

a.研发模式：公司以自主创新为主，重视技术整合，构建七大技术平台，创立鼎龙先进材料创新研究院，灵活、高效地运用公司研发资源，向相关技术领域和业务领域进行新项目的拓展和开发。此外，公司积极与下游客户开展技术合作，根据客户的反馈和诉求进行配方改进和特异化定制开发，加快产品研发速度，保障产品契合客户需求、符合行业发展趋势。

b.采购模式：公司坚持材料技术创新与上游原材料的自主化培养同步，一方面自主开发部分核心原材料并实现产业化生产，另一方面与国内上游材料供应商合作，保障公司上游供应链的安全、稳定。对于部分对外采购的原材料，公司会结合原材料性质、生产计划、物流情况、市场价格等因素储备一定的原材料库存，保障正常的生产需求。

c.生产模式：公司采取以销定产的生产模式，根据订单情况制定生产计划，保证生产活动的合理性、高效性。生产部门会定期依据市场订单的变化及生产进度调整生产计划，以满足客户的产品需求，并提高产品周转率。对于持续大规模供货的产品，公司会持续改良产品的生产工艺，提升生产良率、效率，控制生产成本，优化产成品质量。

d.销售模式：公司半导体CMP制程工艺材料产品的下游客户为国内主流晶圆厂，半导体显示材料产品的下游客户为国内主流显示面板厂，半导体先进封装材料产品的下游客户主要为国内主流封装厂。相关产品的销售采取直销模式，由下游客户直接向公司下达采购订单。

### ④行业发展情况与公司所处行业地位

#### a. 半导体CMP制程工艺材料领域

集成电路产业是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，是国家大力支持发展的战略性新兴产业，半导体材料则是集成电路产业的基石。在汽车电子、5G通讯、智能终端等新兴领域强劲带动下，全球集成电路产能加速扩张；国际地缘政治因素和供应链自主可控的需求助力推进半导体材料自主化进程。CMP抛光材料是集成电路制造中至关重要的半导体材料，根据SEMI数据，CMP抛光材料在集成电路制造材料成本中占比7%，其中CMP抛光垫、CMP抛光液、CMP清洗液合计占CMP抛光材料成本的85%以上。随着国内半导体产业规模的增长和制程工艺的进步、芯片堆叠层数的增加，抛光步骤和CMP耗材用量将会增加，CMP材料市场将进一步扩大。

公司致力于为下游晶圆厂客户提供整套的一站式CMP核心材料及服务：在CMP抛光垫产品方面，公司是国内唯一一家全面掌握CMP抛光垫全流程核心研发技术和生产工艺的CMP抛光垫供应商，相关子公司—鼎汇微电子是国家级专精特新小巨人企业，产品深度渗透国内主流晶圆厂，成为部分客户的第一供应商，并被多家晶圆厂核心客户评为优秀供应商；在CMP抛光液产品方面，公司多线布局多晶硅制程、金属铜制程、金属铝制程、阻挡层制程、金属钨制程、介电层制程等系列近40种抛光液产品，部分产品已实现规模化销售，其他各制程产品覆盖全国多家客户进入关键验证阶段；在清洗液产品方面，公司铜制程CMP后清洗液产品持续稳定获得订单，其他制程抛光后清洗液产品部分在客户端验证反馈良好。

### b. 半导体显示材料领域

显示产业在电子信息产业中占据重要地位，是国家战略性支柱产业，而新型显示产业是新一代信息技术的先导性支柱产业，其中OLED是现阶段显示产业发展的重点领域。近年来国内面板企业对新一代显示技术AMOLED产线大力投建，终端AMOLED面板市场规模持续增长，拉动了新型显示产业供应链上游材料的需求。目前国内显示产业链上游环节较为薄弱，关键原材料本土化程度较低，自主化替代空间较大。

公司紧抓半导体显示材料产业的战略发展机遇期，布局多款新型显示材料，并在相关细分产品上初步取得领先地位：在YPI产品方面，是国内唯一一家拥有千吨级、超洁净、自动化YPI产线的企业，是国内唯一实现量产出货的YPI供应商；在PSPI产品方面，是国内唯一一家在下游面板客户验证通过，打破国外垄断，并在第三季度实现批量出货的企业；此外，公司正在推进面板封装材料INK、OC材料等其他核心半导体显示材料的开发验证、市场推广，助推我国关键半导体显示材料的国产化。

### c. 半导体先进封装材料领域

随着半导体制程节点持续演进，芯片制造成本和难度越来越高，追求经济效能的摩尔定律难以为继。先进封装技术成为打破摩尔定律瓶颈、满足电子产品小型化、多功能化、降低功耗、提高带宽等高需求的关键技术。同时，在全球半导体产业博弈升级的背景下，国内晶圆厂在制程升级上受限，先进封装有望成为国内半导体制程节点持续发展的突破口。先进封装生态涵盖从芯片设计、制造、材料的供应商，台积电、英特尔、三星、日月光等全球主要芯片设计、制造、封装厂商均已加强先进封装领域的技术布局和资本开支，国内各相关厂商在先进封装领域的布局也逐步展开。先进封装技术必然会成为未来驱动芯片行业发展的一大力量。

公司前瞻性布局先进封装材料项目，其中部分产品已在客户端送样测试，验证工作稳步推进中，目前客户端反馈良好。目前国内先进封装技术处于发展阶段，上游先进封装材料环节较为薄弱，供应链自主化程度低。公司将快速推动先进封装材料项目的产品开发验证和产线建设，助力国产先进封装技术的发展和突破，同时也为鼎龙未来的发展继续添砖加瓦。

### ⑤ 主要的业绩驱动因素

**a. 前瞻性长期布局取得成效：**公司从2012年开始向半导体新材料领域转型升级，在集成电路制造用CMP抛光垫材料领域进行布局，通过长期持续研发突破了相关产品的高技术门槛和产业化难关，并在半导体材料领域积累了丰富的经验，帮助公司在国内半导体产业链自主化大趋势下抓住市场机遇，将成熟的开发成果快速转化为经济效益，同时持续拓展在半导体材料领域的产品布局，厚积薄发，助力公司实现长期可持续的业绩增长。

**b. 行业发展前景良好，下游景气复苏：**集成电路产业和新型显示产业都是国家战略性新兴产业，是国家政策坚定支持发展的产业。近年来行业下游制造晶圆厂、面板厂产线建设大力投入，技术持续更新迭代，行业整体规模的快速增长，上游材料市场空间持续扩容。在需求端，消费电子领域在经历2022年下半年需求疲软情况后，2023年库存逐渐去化，行业呈现复苏迹象，这将带动公司半导体CMP制程工艺材料及半导体显示材料产品的销售，对公司业绩有正向驱动作用。

**c. 自主化替代市场机遇：**集成电路制造和新型显示产业是国家战略性支柱产业，在国际政治博弈升级的背景下，保障产业供应链的安全稳定、提升供应链自主化水平是当前行业的大趋势。目前集成电路制造和新型显示产业上游的许多核心材料都被国外企业垄断，供应链自主化程度较低，替代空间较大。公司的CMP抛光垫、CMP抛光液、清洗液及柔性显示基材PI浆料、光敏聚酰亚胺PSPI等产品，以及公司后续持续布局的新材料产品，均为上述进口替代类关键材料，受到了国内客户的欢迎和期待，这对公司产品导入国内下游主流客户端有推动作用，对公司业绩有正向驱动作用。

## (2) 打印复印通用耗材业务板块

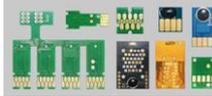
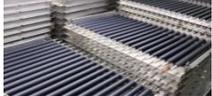
### ① 主要业务

公司是产品体系最全、技术跨度最大的打印复印通用耗材龙头企业，以全产业链运营为发展思路，上游提供彩色聚合碳粉、耗材芯片、显影辊等打印复印耗材核心原材料，下游销售硒鼓、墨盒两大终端耗材产品，实现产业上下游的联动，支持公司的竞争优势地位。

### ② 主要产品及其用途

公司打印复印通用耗材上游产品包括彩色聚合碳粉、载体、通用耗材芯片、显影辊等，是生产硒鼓、墨盒等通用打印耗材的重要原料与部件；终端产品包括硒鼓和墨盒，硒鼓用于激光打印机，墨盒用于喷墨打印机。

表 2.4：公司打印复印通用耗材板块产品简介

产品名称	图片	简介
彩色聚合碳粉		彩色聚合碳粉用于激光打印机里的硒鼓，有黑色、红色、黄色、蓝色四种颜色，具有显影作用。公司2010年成功研制彩色聚合碳粉，2012年实现彩色聚合碳粉的全自动、产业化生产，打破了国外垄断，目前已迭代至第七代低温定影聚酯碳粉产品。
载体		载体是一种内核为铁氧体磁性材料，表面包覆一层高分子树脂的复合材料。载体是双组分显影剂中重要的成份之一，既要带电性还要带磁性，借助载体的磁性，碳粉能更好的附着在显影器上，得到更好的印刷效果。
通用耗材芯片		通用耗材芯片的主要功能为喷墨打印机及激光打印机耗材产品的识别与控制，具有感应、计数、校准色彩的作用。
显影辊		硒鼓中重要的核心组成部件，是使光导体上的静电潜像显影用的辊，具有显影作用和传粉作用，对图像密度有影响。
硒鼓		激光打印机里的耗材，承担了激光打印机的主要成像功能，按其内部感光鼓、磁鼓和墨粉盒的组合方式可分为三类：一体硒鼓、二体硒鼓和三体硒鼓。
墨盒		喷墨打印机中用来存储打印墨水，并最终完成打印的部件，按墨盒和喷头的结构设计可分为一体式墨盒和分体式墨盒，其中再生墨盒多为一体式墨盒，其他通用墨盒多为分体式墨盒。在分体式墨盒中，根据颜色封装的情况又可以分为单色墨盒和多色墨盒。

### ③经营模式

在打印复印通用耗材业务板块，公司形成了极具竞争力的全产业链经营模式，通过终端的硒鼓、墨盒产品带动上游碳粉、芯片、显影辊产品的销售，同时借助先进核心上游产品占领市场。生产方面，公司推进产线自动化建设，降本增效；销售方面，公司通过品牌推广、行业展会、客户服务等方式获取订单，直接销售给国内外客户，同时也通过各大耗材电商平台拓展互联网模式的销售渠道，并严格做好应收账款的管理，控制销售风险。

### ④行业发展情况与公司所处行业地位

打印复印通用耗材行业市场竞争模式较为成熟，通用耗材市场份额更多倾向综合实力强、具有技术卡位和规模优势、品牌影响力较大、产品价低质优的头部企业，降本增效是耗材厂商保持优势地位的重中之重。此外，国家及各地信创相关政策频出并加速落地，国家信息安全战略将促进打印机国产化进程。随着国产打印机市场份额的扩张，国内的通用耗材厂商存在跟原装打印机厂商合作的机会，具有潜在市场空间。

目前，公司是全球激光打印复印通用耗材生产商中产品体系最全、技术跨度最大、以自主知识产权和专有技术为基础的市场导向型创新整合商。彩色碳粉领域，公司是国内唯一掌握四种颜色制备工艺，且规模最大、产品型号最齐全、技术最先进的兼容彩粉企业，目前已迭代至第七代低温定影聚酯碳粉产品。耗材芯片领域，子公司旗捷科技是具有专业集成电路设计与应用能力的国家高新技术企业，纳入国家发改委重点布局软件企业，是国家级专精特新小巨人企业。再生墨盒领域，子公司北海绩迅是中国第一家获得国家质检总局批复的允许进口旧打印机、旧耗材的再制造企业，国家工信部再制造墨盒产品认定的首家企业，是国家级专精特新小巨人企业。

### ⑤主要的业绩驱动因素

耗材上游彩色碳粉、耗材芯片、显影辊产品的销售受终端硒鼓产品销量增长的带动，同时公司持续开发彩色碳粉、耗材芯片等新产品；耗材终端产品方面，在持续拓展市场以外，公司重点关注降本控费、效率提升、管理优化等专项工作，提升终端产品的盈利能力。此外，信创产品和国产打印机市场份额的扩张为公司与原装打印机厂商合作提供了潜在机会，驱动硒鼓业务业绩向好发展。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	5,620,339,183.70	5,107,312,593.88	10.04%	4,450,170,835.10
归属于上市公司股东的净资产	4,214,862,140.07	4,027,815,378.34	4.64%	3,548,737,485.64
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	2,721,483,697.38	2,355,886,991.97	15.52%	1,816,859,092.20
归属于上市公司股东的净利润	390,026,548.37	213,521,066.44	82.66%	-159,824,129.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	348,051,385.99	206,593,917.07	68.47%	-273,210,552.90
经营活动产生的现金流量净额	562,786,027.33	3,119,542.34	17,940.66%	388,501,685.89
基本每股收益（元/股）	0.42	0.23	82.61%	-0.17
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.23	78.26%	-0.17
加权平均净资产收益率	8.97%	5.64%	3.33%	-4.39%

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	569,699,143.28	742,793,954.51	642,908,201.27	766,082,398.32
归属于上市公司股东的净利润	71,368,935.36	123,088,299.20	100,317,563.62	95,251,750.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,709,147.01	107,598,801.08	95,098,454.24	78,644,983.66
经营活动产生的现金流量净额	72,485,955.83	199,707,687.29	214,140,552.68	76,451,831.53

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

### 4、股本及股东情况

#### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,200	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,592	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	--	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	--	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	--
前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			

朱双全	境内自然人	14.69%	139,249,514	104,437,135	--	--
朱顺全	境内自然人	14.56%	138,031,414	103,523,560	质押	7,750,000
香港中央结算有限公司	境外法人	4.56%	43,230,603	0	--	--
招商银行股份有限公司一兴全合泰混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.70%	25,560,294	0	--	--
招商银行股份有限公司一兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.83%	17,306,053	0	--	--
上海理成资产管理有限公司一理成圣远 1 号 A 期私募证券投资基金	境内非国有法人	1.33%	12,601,342	0	--	--
杨浩	境内自然人	1.06%	10,023,188	0	--	--
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.75%	7,080,911	0	--	--
中国银行股份有限公司一易方达战略新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	6,549,300	0	--	--
中国工商银行股份有限公司一易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	6,505,843	0	--	--
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，朱双全与朱顺全系兄弟关系，为公司共同实际控制人。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行为人。					

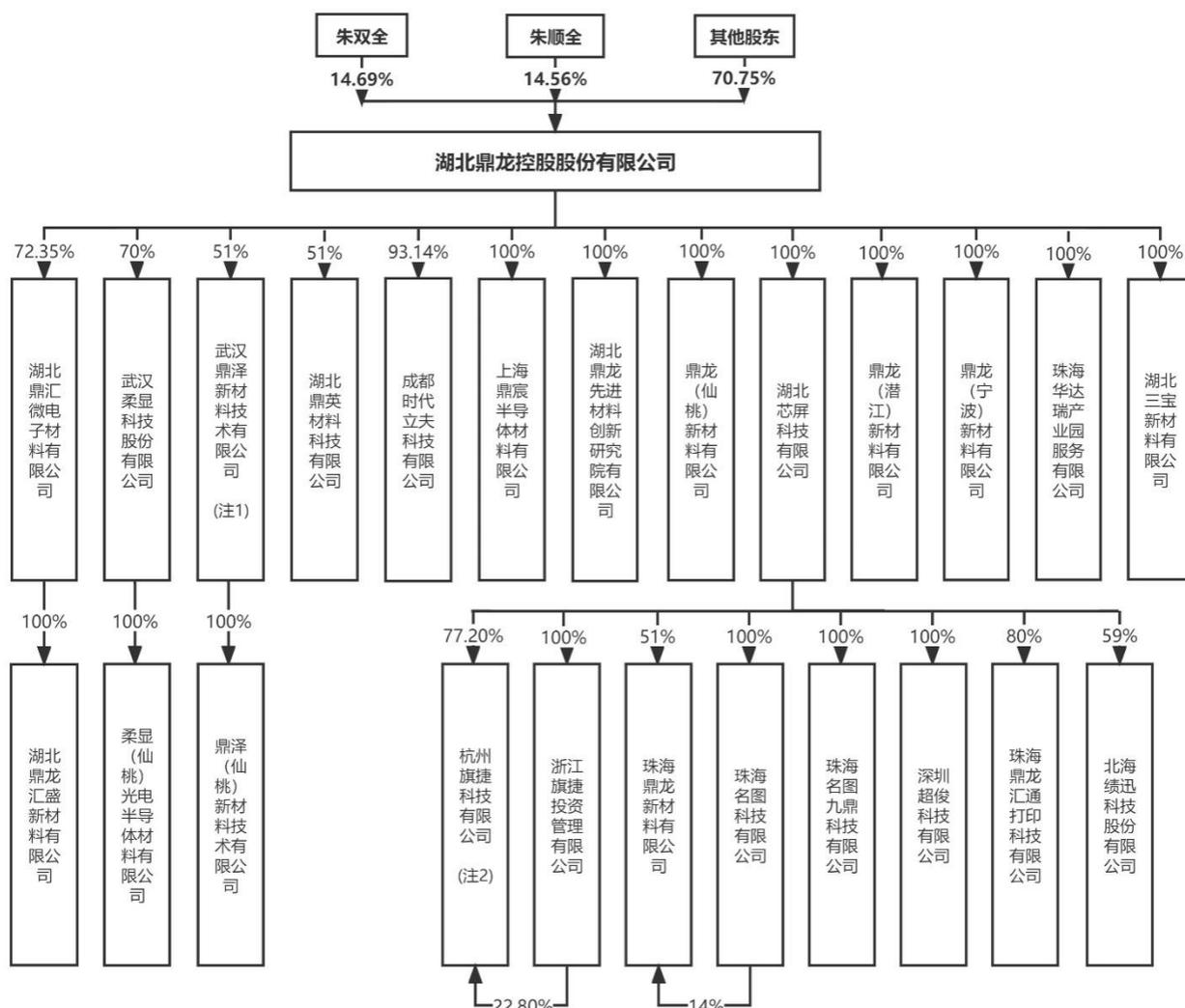
公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 备注:

(1) 经 2022 年 11 月 25 日公司第五届董事会第五次会议审议通过, 公司对控股子公司武汉鼎泽新材料技术有限公司实施股权转让及增资扩股。上述交易完成后, 公司持有鼎泽新材料的股权比例将由 51% 变更为 70%。截至目前, 该事项的工商变更登记正在进行中。

(2) 经 2023 年 1 月 16 日公司第五届董事会第六次会议审议通过, 公司对子公司杭州旗捷科技有限公司实施股权转让及增资扩股。上述交易完成后, 公司通过芯屏科技持有旗捷科技的股权比例由 77.20% 变更为 59.48%、通过旗捷投资持有旗捷科技的股权比例由 22.80% 变更为 20.52%。该事项的工商变更登记已于 2023 年 3 月 7 日完成, 即截至本公告日, 公司合计持有旗捷科技 80% 股权。

## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

### 三、重要事项

具体参见 2022 年年度报告全文。

湖北鼎龙控股股份有限公司

法定代表人：朱双全

2023 年 4 月 11 日